

PSV5000是一款理想的高质量编程设备
并以低总成本实现了高效率及高可靠性编程目标



高效率

高可靠性

高性价比

效率

可靠

性价比

专为实现高性能、高灵活性目标而设计

专为实现最高编程质量，最高编程良率目标而设计

专为实现低编程总成本目标而设计

- ✓ 易于换线的工业设计实现快速编程目标
 - 每小时产能1300片
 - 可扩展至6个FlashCore编程器 (24个 插座)
 - 可扩展至5个LumenX编程器 (40个 插座)
 - 自动化编程设备的理想选择
- ✓ 灵活的配置选项
 - 集成化媒介配置
 - 激光打标
 - 精准的小芯片处理技术 (芯片尺寸: 2毫米x 3毫米)
 - 支持的芯片尺寸可达 42.5 毫米 x 42.5 毫米
- ✓ 提供最全面的器件支持与最完善的技术服务

- ✓ 最高编程质量
 - 高性能适配器
 - 高附加值软件系统
- ✓ 智能化、集成化系统设计
 - 行业领先的编程器、处理技术及软件系统
- ✓ 集成化视觉系统实现精准定位
 - ± 0.03毫米精准定位
 - 支持小尺寸芯片

- ✓ 低编程总成本
 - 显著降低生产人力成本
 - 每个芯片节约3倍成本
 - 最大的插座密度使其所占空间最小，可随产量快速扩展容量
- ✓ 投资保护
 - 充分运用现有的FlashCORE适配器
 - LumenX持续支持新的芯片技术 确保您的投入始终受到保护
- ✓ 全球服务与技术支持
 - 本地化服务与技术支持
 - 区域备件支持

处理系统

- 产量: 每小时1300片的产出量
- 放置精度: ± 0.03 毫米
- 取放方式: 使用步进电机控制上下运动, 伺服电机控制旋转的单吸取头
- 吸嘴: 50 毫米 (最大)
- 定位方式: 视觉对准
- 安全标准: CE, RoHS, WEEE
- 软件系统: 支持 Windows 的 TaskLink, CH700, Windows 7
- 尺寸: 1290毫米 长 x 870毫米 宽 x 1520毫米 高 (不包括选配的媒介和显示屏尺寸)
- 装箱规格: 1310毫米 长 x 930毫米 宽 x 1760毫米 高 (不包括选配的媒介和显示屏尺寸)
- 净重: 450公斤
- 装箱重量: 550公斤

输入/输出选配系统

输入/输出选配

- Tape 输入: 8 毫米 ~ 56 毫米
- Tape 输出: 8 毫米 ~ 56 毫米
- Tray 盘进料器输入/输出: 支持多达种 20 JEDEC 托盘
- 手动 Tray: 可直接安装
- Tube 输入/输出
- 芯片回收器

选配打标机

- 激光标记: 光纤激光器
- 功率: 0 ~ 10 W

服务支持和备件

- PSV5000基本备件包
- PSV5000补充备件包
- PS-Flash 100 软件包
- 操作培训
- 附加服务支持: 享有一年软件及硬件 (耗材除外) 质保, 提供最新软件功能及器件支持和质保范围外的硬件服务支持
- Serial Number Server
- Automotive Performance Pak
- NAND Flash Bad Block Management
- Data Management Software Suite (LumenX only)
- ConneX

规格

电气要求

- 输入电压: 208 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1 PHz
- 最大电流 10 A

温度要求

- 13° C ~ 30° C

编程内核、适配器和全器件支持

编程内核

- 采用结合了 SuperBoost 技术的 FlashCORE III 编程器
- Lumen™X 编程器

插座性能

- 标准插座 (每个插座使用寿命 5,000 - 10,000 次)
- 高性能插座 (HIC) (每个插座使用寿命可达 250,000 次)

全器件支持

FlashCORE III: Flash Memory (NOR, NAND, MCP, MMC, eMMC, UFS, SD, MoviNAND, OneNAND, iNAND, Serial Flash, EEPROM, EPROM 等), Microcontroller 及 Logic 器件 (CPLD, FPGA, PLD)
LumenX: eMMC, SD 和 SPI NOR, 并将支持未来新器件的编程应用

封装支持

- PLCC, SOIC, SON, WSON, SSOP, CSP, BGA, uBGA 及 FPGA, QFP, TQFP, TSOP, PoP, DIP 等

器件编程及测试

- Program, continuity, checksum, blank check, mis-insertion, test, verify, backwards device, two pass verify, ID check,

空气要求

- 气压: 80psi (5.5 bar)
- 气流: 6 SCFM (最大)

湿度要求

- 无凝结湿度 35% ~ 90% RH

